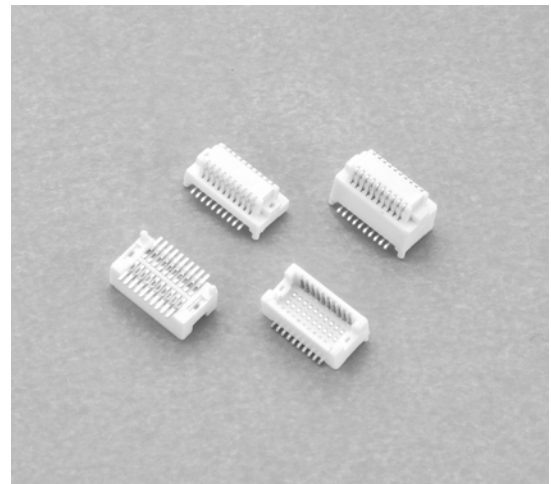


5050

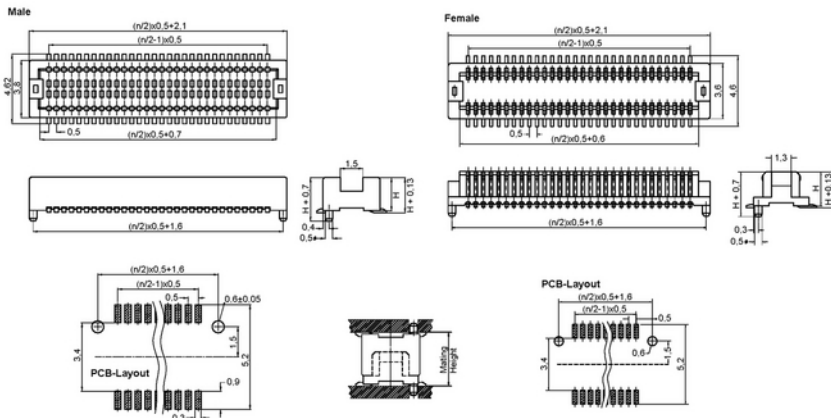
SMT - Board-to-Board Verbinder - RM 0,50mm SMT-Board to Board Connectors - Pitch 0,50mm

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Weiss
Colour	White
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor bronze
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 30mΩ
Contact Resistance	< 30mΩ
Isolationswiderstand	> 100MΩ @ 100V
Insulation Resistance	> 100MΩ @ 100V
Spannungsfestigkeit	100V _{AC}
Test Voltage	100V _{AC}
Nennstrom	0,5A
Current Rating	0,5A
Temperaturbereich	-20°C ... +105°C
Temperature Range	-20°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Mating Heights:	Female				
	Type 5 (H=1,70)	Type 6 (H=2,20)	Type 7 (H=2,70)	Type 8 (H=4,20)	Type 9 (H=4,70)
Male					
Type 1 (H=1,70)	2,5	-	-	-	-
Type 2 (H=2,20)	-	3,0	3,5	5,0	5,5
Type 3 (H=2,70)	-	3,5	4,0	5,5	6,0
Type 4 (H=3,20)	-	4,0	4,5	6,0	6,5

Series	Type*	Contacts*	Plating	Packing
5050	1	040	00	TR
	<p>1 Stift; H=1,70mm Male; H=1,70mm</p> <p>2 Stift; H=2,20mm Male; H=2,20mm</p> <p>3 Stift; H=2,70mm Male; H=2,70mm</p> <p>4 Stift; H=3,20mm Male; H=3,20mm</p> <p>5 Buchse; H=1,70mm Female; H=1,70mm</p> <p>6 Buchse; H=2,20mm Female; H=2,20mm</p> <p>7 Buchse; H=2,70mm Female; H=2,70mm</p> <p>8 Buchse; H=4,20mm Female; H=4,20mm</p>	<p>020/030/040/ 050/060</p> <p>Andere Polzahlen auf Anfrage. More contact options by request.</p>	<p>00 Vergoldet Gold plated</p>	<p>TR</p>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packing Options:
TR Tape & Reel Verpackung ohne PP-Pad / Tape & Reel packing w/o PP-Pad

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Löttempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8 min

